

Lebenslauf

Persönliche Angaben

Name: Morteza Fakhri
Anschrift: Richard-Strauss-Allee 3
42289 Wuppertal
Geburtsdatum: 27.03.1986
Geburtsort: Bonn
Nationalität: deutsch
Familienstand: ledig
Email: m.fakhri@uni-wuppertal.de

Schulische Bildung

1992 – 1996 Grundschole Medinghoven in Bonn
1996 – 2005 Helmholtz-Gymnasium in Bonn
Abschluss: Abitur

Zivildienst

Juni 2005 – März 2006 Zivildienst bei der Katastrophenhilfsorganisation
Help e.V. in Bonn

Studium

April 2006 – März 2009 Student an der Bergischen Universität Wuppertal im
Studiengang Elektrotechnik, Wuppertal
Abschluss: Bachelor of Science
April 2009 – März 2010 Student an der Bergischen Universität Wuppertal im
Studiengang Elektrotechnik, Wuppertal
Abschluss: Master of Science

Beruflicher Werdegang

November 2007 – Juni 2009 Studentische Hilfskraft am Lehrstuhl für Elektronik der
Bergischen Universität Wuppertal
Juli 2008 – Oktober 2008 Werkstudent bei Infineon Technologies AG in München
Juli 2009 – März 2010 Wissenschaftliche Hilfskraft am Lehrstuhl für Elektronik der
Bergischen Universität Wuppertal
Seit April 2010 Wissenschaftlicher Mitarbeit am Lehrstuhl für Elektronische
Baelemente der Bergischen Universität Wuppertal

Auslandsaufenthalte

Januar 2009 – Mai 2009

Auslandssemester an der National University of Singapore

Zusätzliche Informationen

Publikationen:

Tiedemann, A. K., Fakhri, M., Heiderhoff, R., Phang, J.C.H., Balk, L.J.: "Advanced Dynamic Failure Analysis on Interconnects by Vectorized Scanning Joule Expansion Microscopy", The 16th IEEE International Symposium on the Physical and Failure Analysis of Integrated Circuits (2009)

Best Poster Paper awarded at the 16th IEEE International Symposium on the Physical and Failure Analysis of Integrated Circuits (IPFA 2009)

Tiedemann, A. K., Kurz, K., Fakhri, M., Heiderhoff, R., Phang, J.C.H., Balk, L.J.: "Finite Element Analyses assisted Scanning Joule Expansion Microscopy on Interconnects for Failure Analysis and Reliability Investigations", Proc. of the 20th European Symposium on the Reliability of Electron Devices, Failure Physics and Analysis (ESREF 2009)

Heiderhoff, R., Geinzer, A.-K., Fakhri, M., Balk, L.J.: "Strain and Stress Analysis with High Spatial Resolution" The 13th Beijing Conference and Exhibition on Instrumental Analysis (BCEIA 2009)

Fakhri, M., Tiedemann, A. K., Heiderhoff, R., Balk, L.J.: „Finite element Assisted Thermally Induced Strain and Stress Analysis", The 5th European Advanced Technology Workshop on Micropackaging and Thermal Management (IMAPS 2010)

Fakhri, M., Tiedemann, A. K., Heiderhoff, R., Balk, L.J.: „Nanoscale thermally induced stress analysis by complementary Scanning Thermal Microscopy techniques", 21st European Symposium on the Reliability of Electron Devices, Failure Physics and Analysis (ESREF 2010)

Best Paper awarded at the 21st European Symposium on Reliability of Electron Devices, Failure Physics and Analysis (ESREF 2010)

Sprachkenntnisse:

Persisch, Deutsch, Englisch

Softwarekenntnisse:

Microsoft Windows und Office Anwendungen

Matlab, LabVIEW

proEngineer, Mentor Graphics

ANSYS

Wuppertal, November 2010